


제품 사양서 (SPECIFICATION)

제 품 명	칩차단 방지판	
모 델 명	HCEBP-3P	
규 격	2400(W)*500(D)*1750(H)	
타 입	3단 접이형	
중 량	53 kg	
내 하 중	kg / 단	
색 상	그린 (기본)	
제 조 사	흥 부 산 업 (주)	
원 산 지	대 한 민 국	
품질보증	제품 인도일로부터 1년	

[제작 사양]

- ◆ 재 질 : FRAME - 30x30 PIPE
BASE - STEEL PLATE 1.6T, 가림막-폴리카보네이트(P.C)
- ◆ 도장방법 : 정전 스프레이를 이용한 분체도장(두께 60 μ m이상)후 200 $^{\circ}$ C 열처리건조
- ◆ 제작방식 : 부분용접 / 전체 조립식
- ◆ 부자재 : 캐스터*5EA, 경첩*2EA

[제품 특징]

- ★ 차단막은 칩으로부터 작업자를 보호하며 작업공정간 분리도 용이합니다.
- ★ FRAME(BODY)부분은 30X30 PIPE재질로 제작이 되어 견고합니다.
- ★ 투명부분은 내 충격성이 강한 P.C(폴리카보네이트)재질로 되어있습니다.
- ★ 캐스터를 부착하여 필요시 현장배치 및 이동이 용이합니다.
- ★ 3단접이식으로 넓은 공간을 효과적으로 차단합니다.